

モバイル静電キャリア

あらゆる基板を瞬時に接着・剥離

モバイル静電接着技術は壊れやすい非標準の基板や小型デバイスを汚染なくハンドリングするソリューションです。Eshylon社のプラットフォームは並外れた歩留まり、汎用性、コスト、スループットにより薄ウェーハの取り扱い、ウェーハの薄化アプリケーションに比類のない費用対効果を提供します

製造工程での剥離プロセス中の基板の損傷を防ぎます

極薄で繊細な基板は取り扱いが困難です。従来の方法で裏面を薄く加工する際、剥離プロセスで深刻な問題が発生します。接着剤を使用しないアプローチ方法は剥離プロセスによる課題を解決します。

<アプリケーション>

- 薄ウェーハのハンドリング
- ウェーハ薄化
- Fab改造なく既存装置を再利用

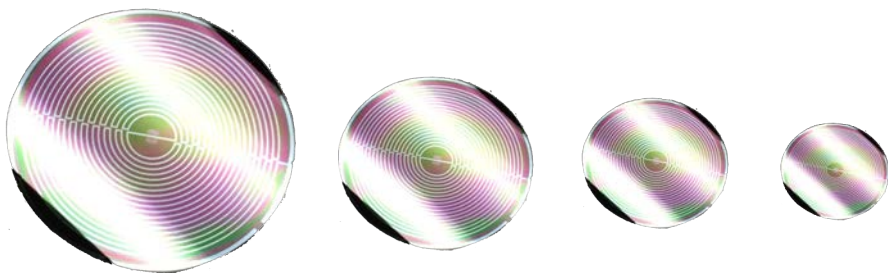


導入メリット

- 高スループット
 - 歩留まり向上
 - 低コスト
 - 広域な用途
 - 接着剤不使用
 - FAB/LAB設備の活用
- 瞬時の接着・剥離による高い処理能力の実現
基板を損傷することなく微細にリリース
1台で接着剥離、再利用可能なキャリア
あらゆる形状、複数サイズに対応
追加のクリーンステップ不要
新たなデバイス開発における迅速な用途変更

キャリア仕様

- サイズ: 100mm
150mm
200mm
300mm



- 厚み : 300um~SEMI規格。カスタム可。
- ベース材 : シリコン、ガラス、石英、セラミック
- Y203コーティングをリリース ※Y203(酸化イットリウム)はプラズマエッチング耐性に優れた材料
- 高温対応: 400°C迄の基板接合に対応 ※接合材料の熱膨張係数の差による熱変形防止

Eshylonの新しいモバイル静電キャリア(MESC)は、最先端のデバイス製造を可能にするためR&D、パイロットライン、量産において困難な基板を処理するプラットフォームを提供します

